

H20年9月11日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第145委員会  
委員長 田島 道夫

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会  
第115回研究会 開催通知

日時：2008年10月17日(金) 13:00～17:35

会場：明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 3階

[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)

東京都千代田区神田駿河台1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

テーマ「半導体材料の機械加工の現状と将来」－究極の低コスト&高精度加工技術を求めて－

世話人：土肥俊郎(九州大学)、末岡浩治(岡山県立大学)

原田博文(シルトロニック・ジャパン(株))

プログラム

- 13:00～13:05 開会の挨拶 田島道夫
- 13:05～13:10 はじめに 原田博文
- 13:10～13:50 「シリコンウェハのワイヤソースライスと平面研削の取組み」  
川辺知秀(コマツNTC(株)SC営業部次長)
- 13:50～14:30 「ラップ・ポリッシュ加工技術の現状と将来」  
杉下 寛(浜井産業(株)技術部部长)
- 14:30～15:10 「HDD 研削加工技術の現状と将来」  
橋本通孝(鋼板工業(株)工場長)
- 15:10～15:30 休憩
- 15:30～16:10 「切断理論の基礎」  
金沢憲一(千葉工業大学 工学部機械サイエンス学科)
- 16:10～16:50 「半導体材料の延性モード加工」  
閻 紀旺(東北大学 大学院ナノメカニクス専攻)
- 16:50～17:30 「ナノ切削現象とその応用」  
森田 昇(富山大学 工学部機械知能システム工学科)
- 17:30～17:35 おわりに 土肥俊郎
- 17:40～19:40 懇親会 (場所：リバティータワー23階 サロン燦)

以上